

Винахід стосується сільського господарства. Спосіб висіву культурних рослин, в якому здійснюють поверхневий обробіток ґрунту з одночасним посівом насіння культурних рослин, який включає: розкидання насіння культурних рослин по поверхні поля, зрізання верхнього шару ґрунту за допомогою обертових кільцевих робочих елементів, підняття зрізаного шару з подальшим розпушуванням та розділенням, а також формування шаруватого покриття, яке складається з насінневого ложа, шару дрібногрудочкуватого ґрунту та верхнього шару, утвореного з пожнивних залишків та скошених бур'янів, що являє собою шарувату мульчу. Технічний результат: збільшення площі живлення рослин, зберігання та накопичення вологи протягом вегетаційного періоду рослини, зменшення собівартості сівби та підвищення урожайності культурних рослин.